

4-3-2 その他（はんだコーティング（HAL）欠陥）／ 其它（热风整平（HAL）的缺陷）／Others(solder coating (HAL) defects)

4-3-2-1 異物巻込はんだ／卷入杂物的焊料／Entrapped foreign object in solder

【特徴】 はんだコーティング層に何らかの異物が巻込まれている状態の欠陥

【特征】 热风整平层卷入某种杂物的缺陷。

【Characteristics】 A foreign object is entrapped in the solder coated layer.

【原因・判断ポイント・発生工程】 H A L のはんだ浴槽に入り込んだ異物が、はんだコーティング層に残って出来たもの（H A L 工程）

【原因、判断要点、发生工序】 落入 HAL 焊料槽的杂物又转移到热风整平层所引起的（HAL 工序）。

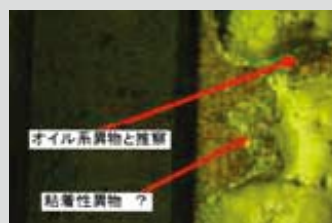
【Causes/processes involved/keys to judgment】
A foreign object in the HAL solder bath is left in the solder coated layer. (HAL process)



【コメント】
顕微鏡倍率× 100

【注釋】
显微镜倍率 × 100

【Comments】
Magnification: ×100



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

4-3-2-2 穴内はんだ詰り／孔内堵塞焊料／Solder plugged hole

【特徴】 はんだがスルーホールや非スルーホール内に詰まっている状態の欠陥

【特征】 通孔或者非通孔内堵塞焊料的缺陷。

【Characteristics】 A plated through hole or non-plated through hole is plugged with solder.

【原因・判断ポイント・発生工程】 H A L 装置のエア噴射圧が低過ぎたり、噴射タイミングが悪かったりして出来たもの（H A L 工程）

【原因、判断要点、发生工序】 HAL 装置的风刀压太低，或者定时吹风不佳而造成的（HAL 工序）。

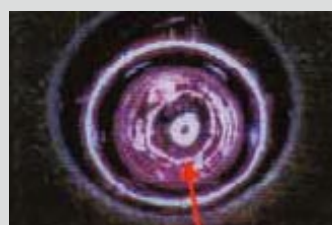
【Causes/processes involved/keys to judgment】
The defect is caused by too low an air-jet pressure or an improper timing of air jetting in HAL process (HAL process)



【コメント】
顕微鏡倍率× 25

【注釋】
显微镜倍率 × 25

【Comments】
Magnification: ×25



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×